

세계와 함께 성장하는 일류기업 이수페타시스
To be a World Wide Company ISUPETASYS

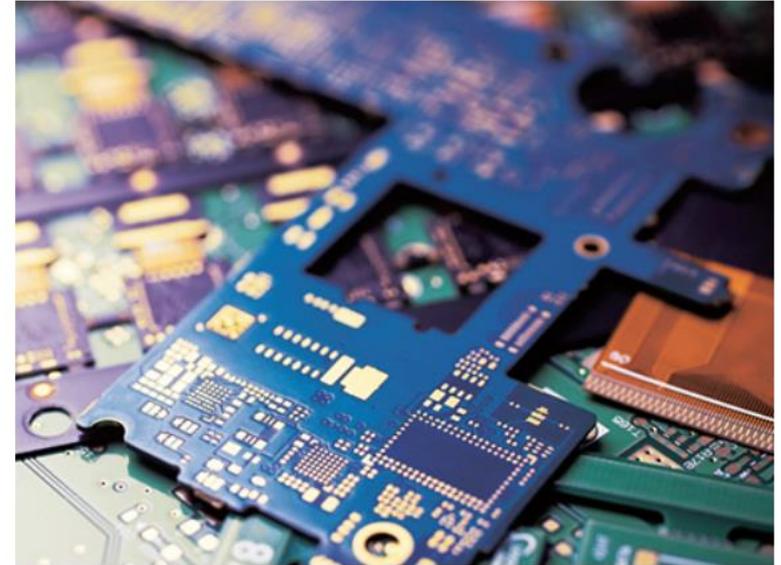


Table of Contents

01 Investment Highlights

02 Company Overview

03 Appendix

Disclaimer

본 자료는 투자자들에게 정보를 제공하기 위한 목적으로 (주)이수페타시스(이하 “회사”)에 의해 작성되었으며 임의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려드리는 바입니다.

본 자료의 열람 또는 수취는 위와 같은 제한 사항의 준수에 대한 동의로 간주될 것이며, 제한 사항에 대한 위반은 관련 증권거래 법률에 대한 위반에 해당될 수 있음을 유념해주시기 바랍니다.

본 자료에 포함된 “예측정보”는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로, 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 ‘예상’, ‘전망’, ‘기대’, ‘(E)’ 등과 같은 단어를 사용합니다.

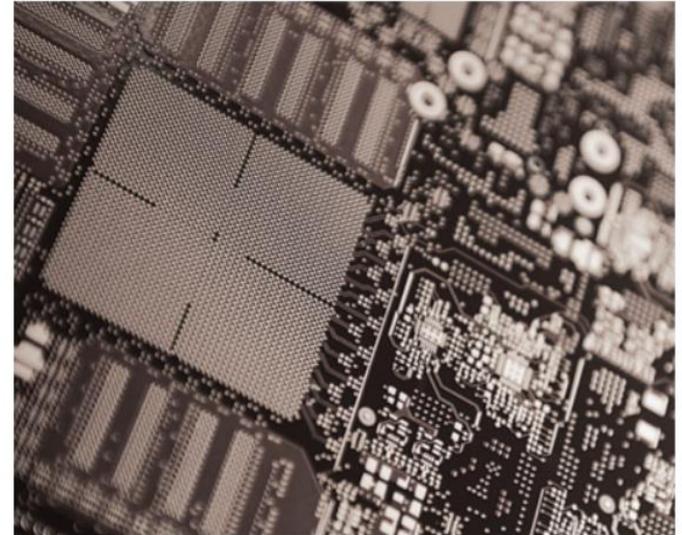
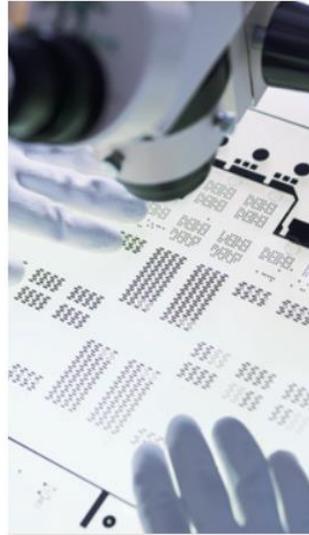
위 “예측정보”는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래 실적은 “예측정보”에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다.

또한 향후 전망은 발표 실시일 현재를 기준으로 작성된 것이며 현재 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로 향후 시장환경의 변화와 전략수정 등에 따라 변경될 수 있으며, 별도의 고지 없이 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 자료의 활용으로 인해 발생하는 손실에 대하여 회사 및 회사의 임직원들은 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다.

본 문서는 주식의 매매를 위한 권유를 구성하지 아니하며 문서의 그 어느 부분도 관련 계약 및 약정 또는 투자결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없음을 알려드립니다.

01



Investment Highlights

01. 매출 성장 본격화, 수익성 개선
02. AI가속기 매출 확대, 제품 MIX 개선으로 수익성 개선
03. 네트워크 물량 회복 전망, 800G 양산 진입

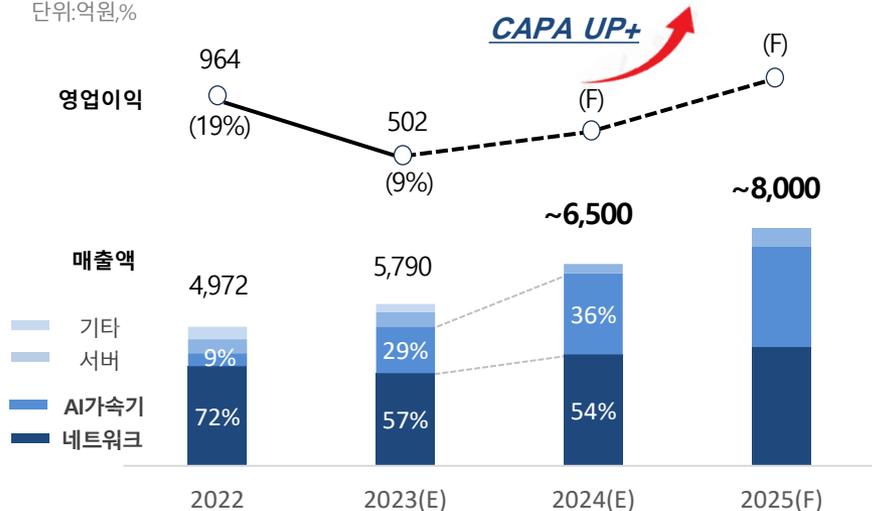
01

매출 성장 본격화, 수익성 개선

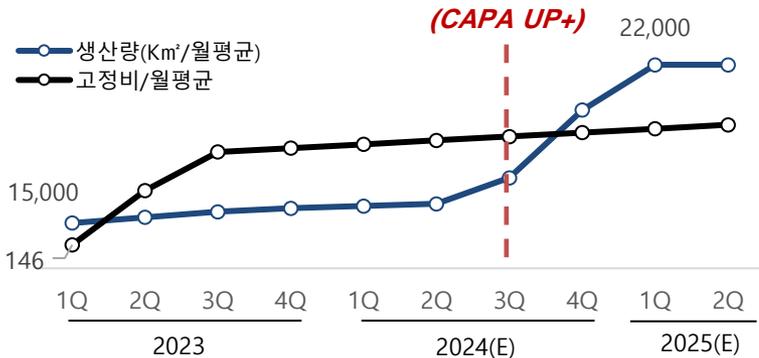
CAPA 확장, 성장 기반 확보

[연간 손익 추이, Petasys 별도 기준]

단위: 억원, %



[CAPA 증설완료 효과 시점_영업레버리지]



매출 확대 및 수익성 개선

① AI가속기 매출 지속 확대

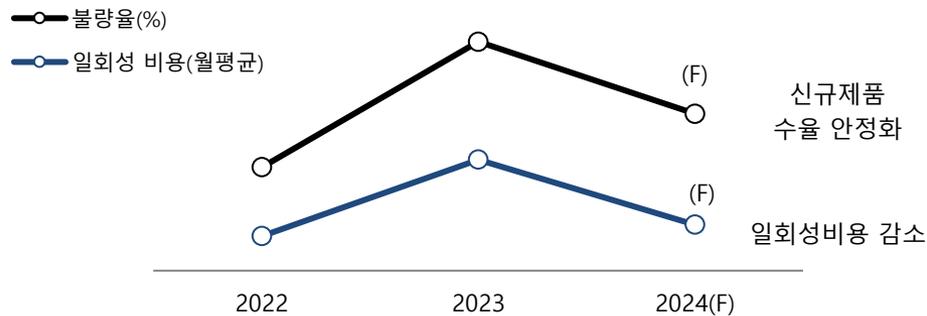
- AI가속기 매출 비중 '23년 29% → 36% 전망
- AI가속기 제품 MIX 개선 (고부가 신규제품 매출 증가)

② 네트워크 부문 일부 고객사 물량 회복세 (23.3Q 이후)

③ 신규제품 수율 개선 및 일회성 비용 감소 전망 (수선유지비, 소모자재비 등)

[불량률 & 일회성비용 추이]

단위: 억원, %



※ '24년 공정 재배치 마무리 단계로 일회성 비용(소모자재비/수선유지비) 및 불량률 감소

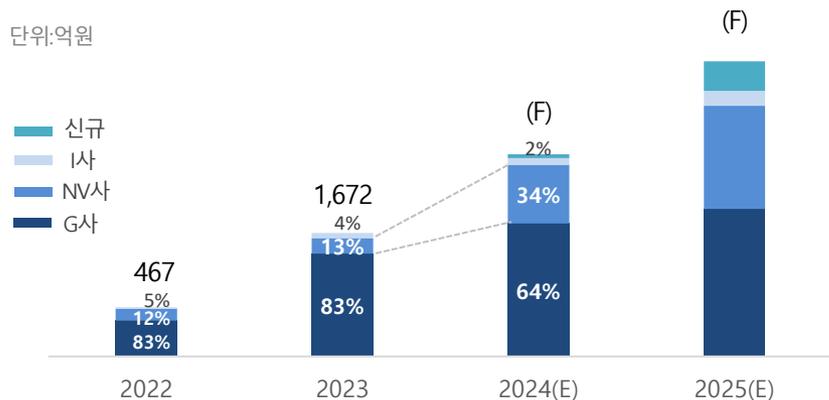
02

AI가속기 매출 확대, 제품 MIX 개선으로 수익성 개선

AI가속기 매출 증가

- G사/NV사 중심 AI가속기 매출 확대 지속
[AI가속기 매출추이]

단위:억원



[AI가속기 현황]

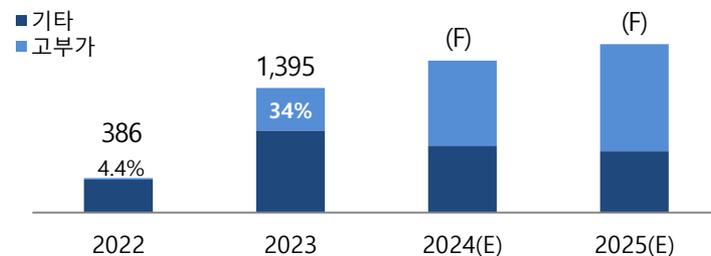
- 주력모델 수요 지속 및 차기모델 양산 물량 확대 전망

구분	주요내용
G사	<ul style="list-style-type: none"> * 차기모델 양산 예정, 물량 증가 전망 * 현 진행 샘플 모델 수 30개 ('23년말 기준)
NV사	<ul style="list-style-type: none"> * 기존모델 전방 수요 증가 영향에 물량 증가 * 신규모델 샘플 진행 중 * 현 진행 샘플 모델 수 10개 ('23년말 기준)

G사 AI가속기 제품 MIX 개선

- G사 AI가속기 고부가 모델 증가
[G사,고부가 매출비중]

단위:억원



G/NV사 외 신규 고객 확대 추진

- 고객사별 칩 자체 개발 추세 확산에 따른 고객 확대 진행 (ASIC 기반)
- ※ 2024년 AI ASIC 예측 점유율



구분	주요내용
Ms사	<ul style="list-style-type: none"> * AI가속기 모델 견적 진행 중 - 현재 서버 제품 양산 진행 * 샘플 모델수 5개 ('23년말 기준)
A사	<ul style="list-style-type: none"> * AI가속기 모델 견적 진행 중

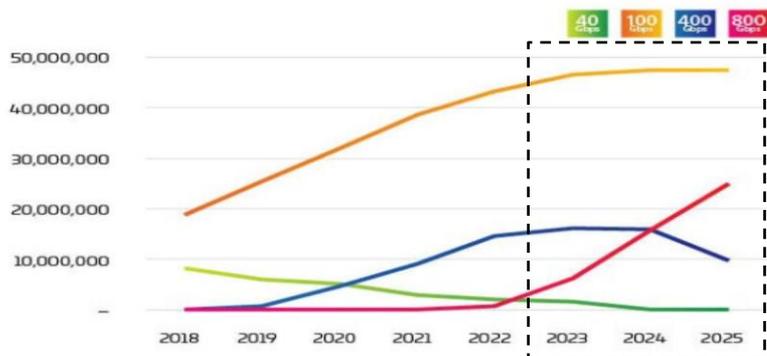
※ Source : Morgan Stanley report (23.09)

03

네트워크 물량 회복 전망, 800G 양산 진입

800G 이더넷 스위치 가속화 전망

- 급성장하는 800G 시장, 대역폭과 성능에 대한 높은 요구



※ Source : 650 Research Group

[400/800G Ethernet 신규 스위치 Chip 발표 현황]

- 시장선도 업체 Broadcom 외 51.2T 신규 스위치 칩 발표



※ Source : Wheeler's Network

[스위치 고성능화 주요 배경]

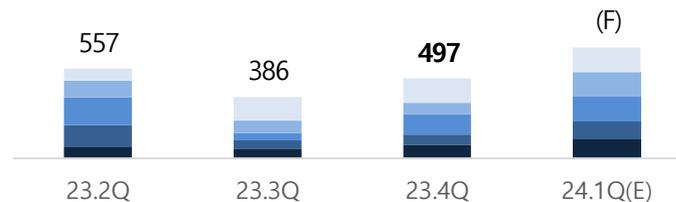
- AI 활용 증대에 따른 데이터 트래픽 증가로 네트워크 부하 가중
- 대역폭 요구의 증가 : 높은 해상도, 대용량 파일 전송

당사 네트워크 부문 현황

- 네트워크 물량 점진적 회복세 [주요고객사 수주 추이]

단위:억원

- G사
- A사
- Cel사
- C사
- N사

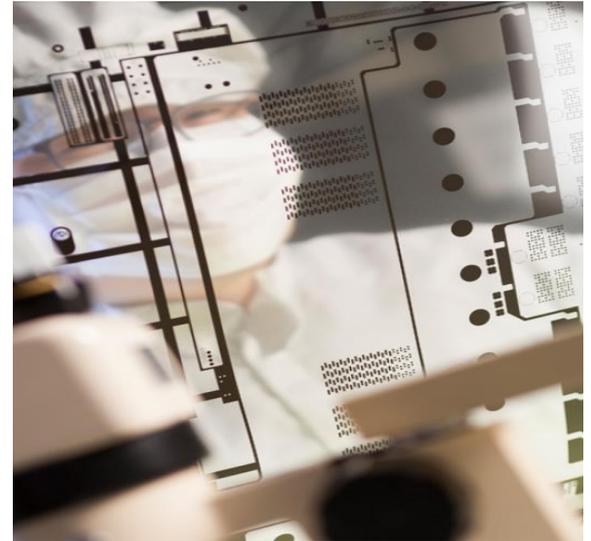


'네트워크 800G 양산 전망'
(*24년 하반기 시점)

- PCB 고사양화 지속 및 다중 적층 기술 대응 중

구분	주요내용
C사	* 데이터센터향 대량 모델 2중 수주/매출 증가 전망 - 800G 시장 선점을 위한 가장 활발한 움직임
J사	* 800G 라우터용 제품 '24년 하반기 초도양산 전환 예정
A사	* 800G 스위치용 제품 '24년 하반기 초도양산 예정
Cel사	* '24년 하반기 양산 계획 (물량 확보 예정)
G사	* G사 데이터센터향 스위치 물량 점진적 증가 (23.3Q 이후)

02



Company Overview

01. PCB부문 사업장 소개
02. 연결 및 각 사별 실적 추이
03. Global PCB 업체 순위
04. 초고다층 PCB시장 Leading Company
05. 중국법인 생산체제 안정화

01

PCB부문 사업장 소개

국내 사업장

해외 사업장

ISUpetasys(대구)

ISUexaboard(안산)

ISUpetasys Hunan(중국)

ISUpetasys Corp(미국)



창립

1989년

2005년

2013년

2001년

보유인증

AS 9100(우주항공)
NADCAP(우주항공)
TL 9000 / TS 16949
ISO 9001

'22년 청산 완료

TS 16949
TL 9000
ISO 9001

TS 16949
TL 9000
ISO 9001

ITAR(군수)
ISO 9001

주력제품

초고다층 (20L ↑)
App.
- 네트워크/서버 장비
- 시가속기
- 슈퍼컴퓨터
- 우주항공

1. HDI(~12층)
- App. 휴대폰 / 카메라
2. RFB(~10층)
- 휴대폰 / TSP / Tablet PC

MLB (4~18층)
App.
- 네트워크/서버
- 자동차용 Radar(전장)

초고다층(샘플,~50층)
App.
- 네트워크/서버 장비
- 시가속기
- 슈퍼컴퓨터
- 우주항공

원자재

Super Ultra low Loss
Ultra low Loss
Low Dk, Df / High Tg
Lead and Halogen Free

Low Dk
High Tg
Halogen Free

High Tg
Middle Tg
Low Tg

Low Dk, Df
High Tg
Lead and Halogen Free

주요고객

N사, C사, G사, M사(舊 F사)
J사, A사 등

삼성전자, LG전자
파트론, 아모텍

O사, C사, N사
P사, I사 등

N사, C사, G사, M사(舊 F사)
J사, A사 등

02

연결 및 각 사별 실적 추이

매출 및 영업이익

(단위: 억원)

회사	구분	2019	2020	2021	2022	2023(E)
페타시스	매출	3,188	3,351	3,635	4,972	5,790
	영업이익	189	222	437	964	502
엑사보드 (청산완료)	매출	1,426	1,210	555	-	-
	영업이익	(270)	(108)	(271)	-	-
중국법인	매출	342	509	921	1,427	1,219
	영업이익	(205)	(107)	24	203	152
미국법인	매출	312	292	322	371	356
	영업이익	13	(36)	8	(6)	(38)
연결기준	매출	5,142	5,142	4,696	6,429	6,753
	영업이익	(240)	20	469	1,166	622

Cf. 연결실적 및 중국법인 금액은 감가상각비 조정(K-IFRS)을 포함한 수치임.

적용제품

유선 장비



C사 Router



N사 Router



A사 Switch

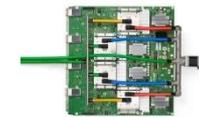


G사 Server

AI 가속기



NV사 AI가속기



G사 AI가속기

무선 장비



S사 5G장비



E사 5G장비

03

Global PCB 업체 순위

Global 3위 > 고다층 PCB(18L 이상) 제조사 중 Global 매출 3위
(국내 MLB PCB 매출 1위)

18층 이상 PCB 업체 매출 순위

Rank	Company	18L 이상 매출(M \$)
1	TTM	269
2	WUS	244
3	ISU Petasys	222
4	Shennan	138
5	Gold Circuits	118
6	Sanmina	72
7	Tripod	70
8	Daeduck	65
9	Shengyi	61
10	Yamamoto	60
11	Others	262
Top 10 Total		1,319

World Top PCB makers in 2021

Rank	Company	18L 이상 매출(M \$)
1	Zhen Ding	5,534
2	Unimicron	3,920
3	Dongshan	3,180
4	Nippon Mektron	2,795
5	Compeq	2,260
6	Tripod	2,257
7	TTM	2,249
8	Shennan	2,163
9	NanYa PCB	1,871
10	AT&S	1,712
57	ISU Petasys	416
Top 10 Total		27,941

*Source : Prismark Report(2022.07)

04

초고다층 PCB 시장 Leading Company

Advanced Level PCB 제조

차별화된 기술력 기반, 중장기적 MLB 사업 경쟁력 확보

높은 PCB 제조 기술력을 기반으로 글로벌 빅테크 고객 다변화 진행

선도적인 기술력 및 품질

· 핵심 공정에 대한 높은 제조 기술력 보유

Global Advanced Level PCB 제조 기술력 보유

· 선도적인 기술력 보유

핵심 공정

적층/회로



도금



홀가공



원자재 개발



기술 구분



적층 및 고정밀 정합 기술



고정밀 도금

고정밀 홀가공

고난이도 홀메공



신호 고속화 측정

※ 기술등급 Segment (C사,N사 등)

(당사)



지속적인 MLB 사업 영위 (시장 점유율 확대)

- 50년간 PCB 제품 생산 & MLB 생산 지속 영위 & 성장 지속
- Global IT 업체 고객사 대다수 확보로 고객 포트폴리오 다변화

→ 시장 잠재력이 큰 신규시장(AI 가속기 등) 진입
중장기적 사업 경쟁력 확보

05 중국법인 생산체제 안정화

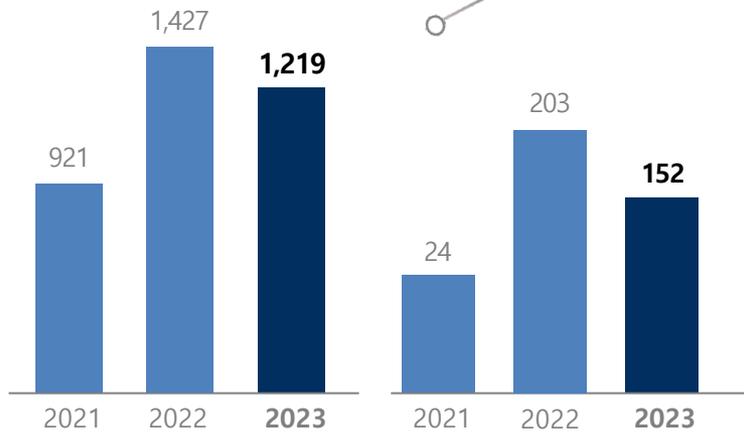
고부가 제품 지속 확대

신성장 동력 고부가 제품 지속 발굴, 안정적 생산체제 구축

중국법인 중다층(12L) 생산 안정화 및 고부가 제품 증가를 통한 수익성 확대 주력

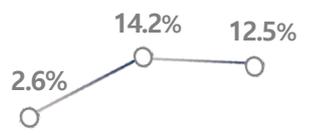
Sales

■ 매출액



Operating Profit

■ 영업이익 (단위: 억원)
○ 영업이익률

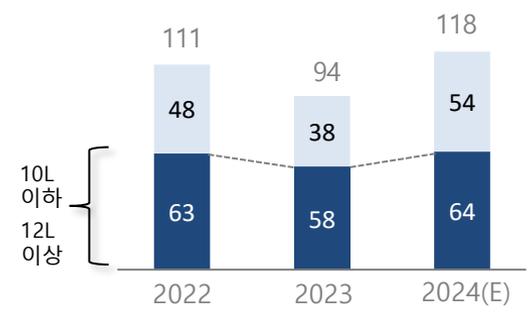


중다층/미주향 물량 지속

• 중다층(12L) 중심의 고부가 물량 지속
'23년 중다층 비중 62% 수준

[제품군 매출 현황]

■ 중다층(12L) 매출 (단위: \$ 백만)
■ 저층(10L 이하) 매출



Cf. 평균 판매단가 추이

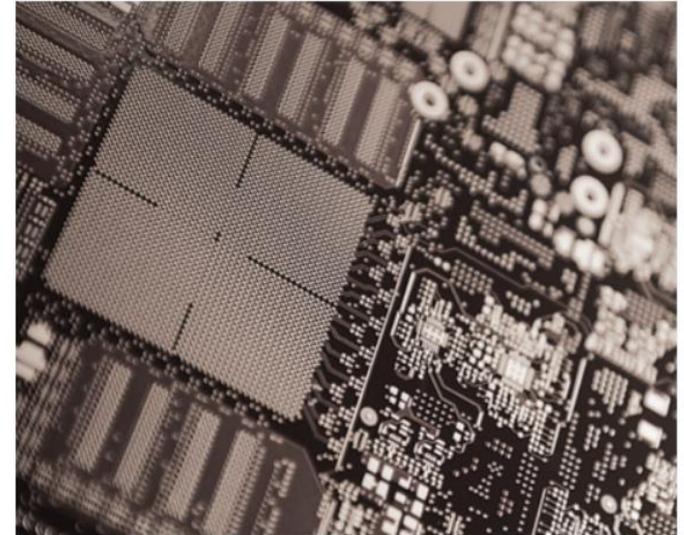
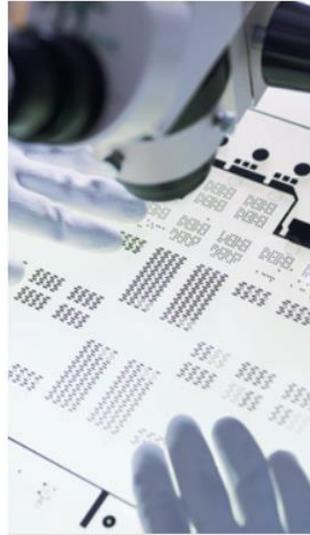


[24년 중점 추진 계획]

구분	미주고객	신규고객
추진 현황	<ul style="list-style-type: none"> * 미주고객 수주 회복 및 M/S 확대 * O사 Major 물량 확보 전망 * C사/N사 Std. Level 양산 확대 	<ul style="list-style-type: none"> * G사 신규 제품 양산 추진 * E사 5G기지국 관련 제품 양산 추진 * 그 외 서버/전장/의료 관련 신규고객 BIZ Contact 中

미주고객 수주 회복 및 M/S 확대
Oracle 차기 프로젝트 양산 등 수익성 확보 주력

03



Appendix

- 01. 요약재무제표
- 02. ESG평가 및 인증

01

요약재무제표

재무상태표

단위:억원

과 목	2019	2020	2021	2022	2023(E)
유동자산	2,247	2,243	3,103	3,739	3,819
비유동자산	1,920	1,651	1,394	1,721	2,426
자산총계	4,167	3,894	4,497	5,460	6,245
유동부채	3,026	2,950	2,982	2,860	2,901
비유동부채	381	292	260	377	700
부채총계	3,407	3,243	3,242	3,237	3,601
자본금	413	413	632	632	632
자본잉여금	157	175	637	810	810
이익잉여금	168	7	(54)	765	1,138
자본총계	760	651	1,255	2,223	2,644

포괄손익계산서

단위:억원

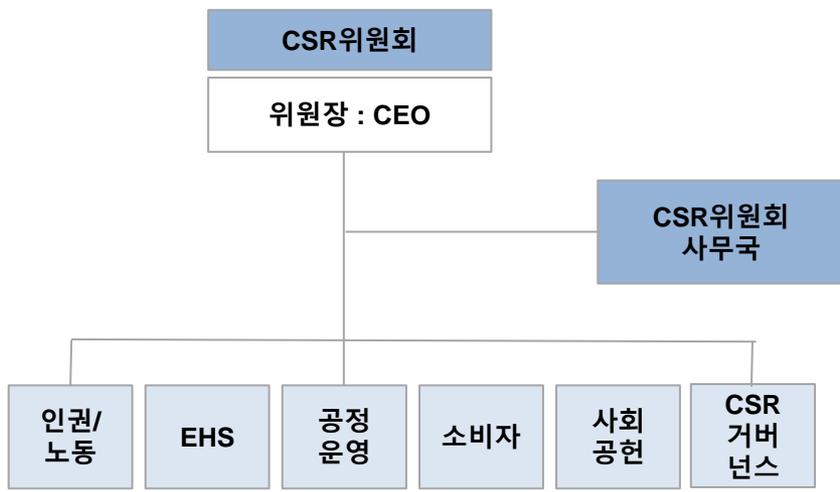
과 목	2019	2020	2021	2022	2023(E)
매출액	5,142	3,932	4,696	6,429	6,753
매출원가	4,878	3,421	3,841	4,790	5,589
매출총이익	264	512	855	1,639	1,164
판매관리비	504	384	386	473	543
영업이익	(240)	128	469	1,166	622
영업외수익	28	63	34	39	313
영업외비용	401	63	9	16	388
법인세차감전순이익	(718)	26	430	1,078	547
법인세비용	193	29	114	75	75
중단영업이익(손실)	-	(132)	(353)	21	-
당기순이익	(911)	(135)	(36)	1,025	471

※ 연결재무제표 기준

02 ESG 평가 및 인증

CSR위원회 조직도

*CSR : Corporate Social Responsibility(사회적 책임의식)



- '15년 첫 CSR보고서 발간, CSR 성과 매년 외부 공개
→ 투명한 사회적 기업 경영 활동 진행 중

ESG 성과 평가 결과

구분	'23년	'22년	'21년	'20년	비고
서스틴 베스트	BB	AA	AA	A	<ul style="list-style-type: none"> 전체 순위 (582위/1270개) 하드웨어 및 IT 장비 섹터 23위 (23위/68개)

※ '23년 성과결과표 상세내역

구분	점수	섹터 평균	가중치
환경(E)	59.85	23.36	25%
사회(S)	57.59	38.84	35%
지배구조(G)	49.27	53.11	40%

다수 인증 확보



주요 수상

- "TOP Direct component supplier"('19)
- "Excellence in Technology"('19)
- "Supplier of the year"('08) (PCB 업계 최초)
- "Excellence In Quality"('10)
- "Supplier of the year"('09)

End of Document